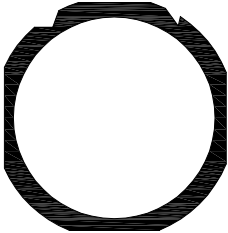
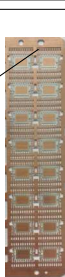
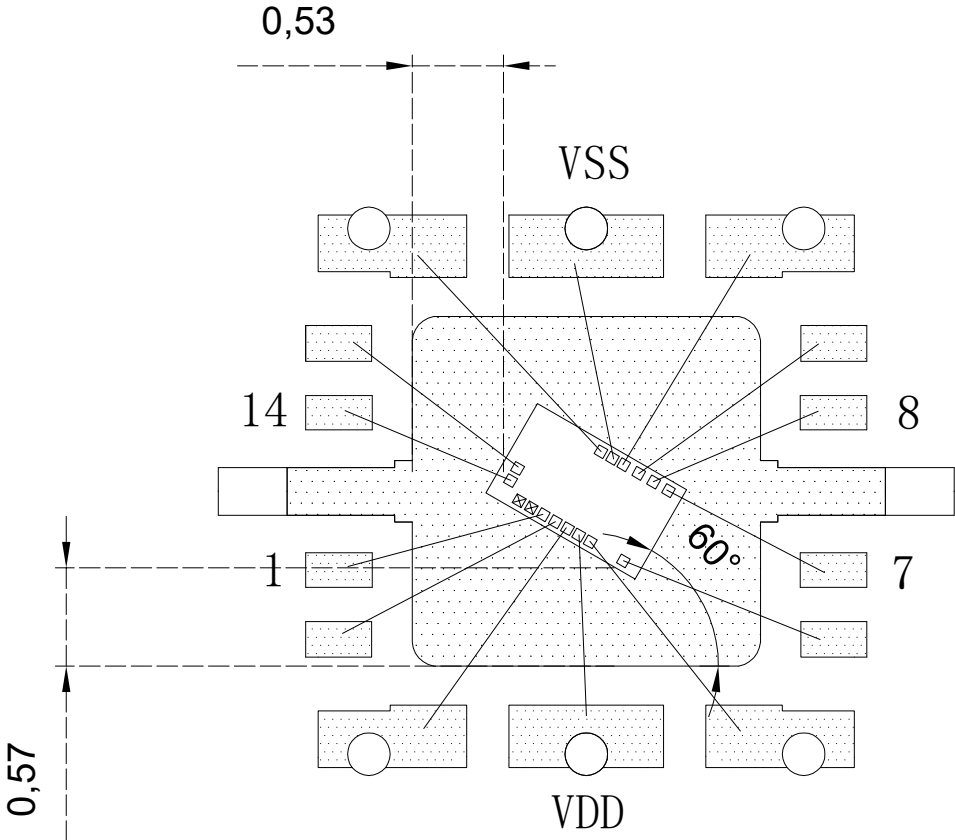


江苏芯丰集成电路封装压焊图		图号:314BD008	版本	A.0
贴片方向（芯片与片环方向示意图） 	框架传输进料方向 第一个孔为椭圆孔 			
		备注及特殊要求（Remark&Special Instruction）		



顶针		点胶方式					
单顶针	多顶针	点胶	画胶				
	/		/				
产品型号 (Product Type) :		HS16F3211H		线材直径 (Wire Diameter) :	银合金线0.8mil	芯片减薄厚度 (Chip thinning thickness)	300±10um
芯片名称 (Die Name) :		HS5130		压焊点尺寸 (Pad Opening) :	60X60um	装片胶 (Epoxy)	首选 9246LB5(导电胶)
芯片尺寸: (Die Size) :		1.002X0.598mm		最小压焊间距 (Min Pitch) :	76um		备选 S610C(导电胶)
封装形式 (Package Type) :		SOP14 (8.65X3.9X1.4 e=1.27)		先焊线 (Wire Bond Start):	PIN11	塑封料 (Molding Compound)	首选 GR710GN
引线框 (Lead Frame) :		SOP14L (12R) (80×80)		焊线总数 (Quantity of Wire) :	14		备选 /
L/F电镀方式 (L/F Plating Type):		雾锡		最长线长(Length of longest Wire):	1.56mm	CUP/BOAC	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
晶圆尺寸 (Wafer Size) :		8寸		顶层铝厚 (Top Al Thickness):	0.8um(3层)	RF 芯片	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO
吸嘴 (suction nozzle)		RR10X10		切割道 (Cutting Way)	60um	LOW-K芯片	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO
拟制 Prepared by		李佳欣 2022.9.1		审核 Checked by		批准 Approved by	